

2016年(平成28年)3月期 決算説明会

2016年5月17日

株式会社フジミインコーポレーテッド

目 次

✓ 決算概要	P. 2
✓ 用途別売上高	P. 10
✓ 設備投資額・減価償却費・研究開発費	P. 21
✓ 損益分析	P. 24
✓ 補足説明資料・マーケットデータ等	P. 27

決算概要

2016年3月期 連結決算サマリー

【業績】

- 半導体・スマートフォン需要減退により売上高3%減、営業利益20%減
- 一般工業用(研磨材)分野の新規用途向け製品は、最終製品の販売の影響を受け減収
- シリコンウェハー向け製品は、半導体需要減退の影響により前期並に留まる
- CMP向け製品は、半導体需要減退の影響受けるもアジア向け最先端ロジック、メモリーデバイス向けが好調に推移し最高売上を記録
- ハードディスク向け製品もアルミ基板用途で当社シェア拡大により増収

【投資】

- 台湾子会社では次世代(10nm/7nm)向け製造ライン拡張中(2016/3期～2017/3期 投資合計8億円)
- CVCファンドの設立(3億円)

決算概要（通期実績）

単位:百万円	15年3月期	16年3月期					
	通期実績	期初予想 (' 15/5)	修正予想 (' 16/2)	通期実績	前年比	期初(' 15/5) 予想比	修正(' 16/2) 予想比
売上高	32,815	34,000	31,700	31,755	△3.2%	△6.6%	+0.2%
営業利益	4,128	4,100	3,200	3,302	△20.0%	△19.5%	+3.2%
営業利益率	12.6%	12.1%	10.1%	10.4%	-	-	-
経常利益	4,596	4,200	3,500	3,342	△27.3%	△20.4%	△4.5%
経常利益率	14.0%	12.4%	11.0%	10.5%	-	-	-
当期純利益	3,695	3,100	2,400	2,346	△36.5%	△24.3%	△2.3%

売上:スマートフォン・半導体市場の減速を受け減収
(' 16年2月下方修正予想水準は確保)
利益:減収および販売管理費の増加により減益

決算概要（半期実績）

単位:百万円	15年3月期		16年3月期					
	上期実績	下期実績	上期実績	前年同期比	前年下期比	下期実績	前年同期比	同年上期比
売上高	16,363	16,451	16,753	+2.4%	+1.8%	15,002	△8.8%	△10.5%
営業利益	2,033	2,094	2,187	+7.6%	+4.4%	1,115	△46.8%	△49.0%
営業利益率	12.4%	12.7%	13.1%	-	-	7.4%	-	-
経常利益	2,236	2,359	2,441	+9.2%	+3.5%	901	△61.8%	△63.1%
経常利益率	13.7%	14.3%	14.6%	-	-	6.0%	-	-
当期純利益	1,858	1,836	1,739	△6.4%	△5.3%	607	△66.9%	△65.1%

- ・上期は前年を上回ったものの、下期は対前年、対上期ともに減収減益
- ・主要因は一般工業用研磨材の需要減退による売上減少
- ・下期にて円高による為替差損(2.4億円)を計上

業績予想（通期）

単位：百万円	15年3月期	16年3月期	17年3月期	
	通期実績	通期実績	通期予想	前年比
売上高	32,815	31,755	33,000	+3.9%
営業利益	4,128	3,302	3,800	+15.1%
営業利益率	12.6%	10.4%	11.5%	－
経常利益	4,596	3,342	3,900	+16.7%
経常利益率	14.0%	10.5%	11.8%	－
当期純利益	3,695	2,346	2,800	+19.3%

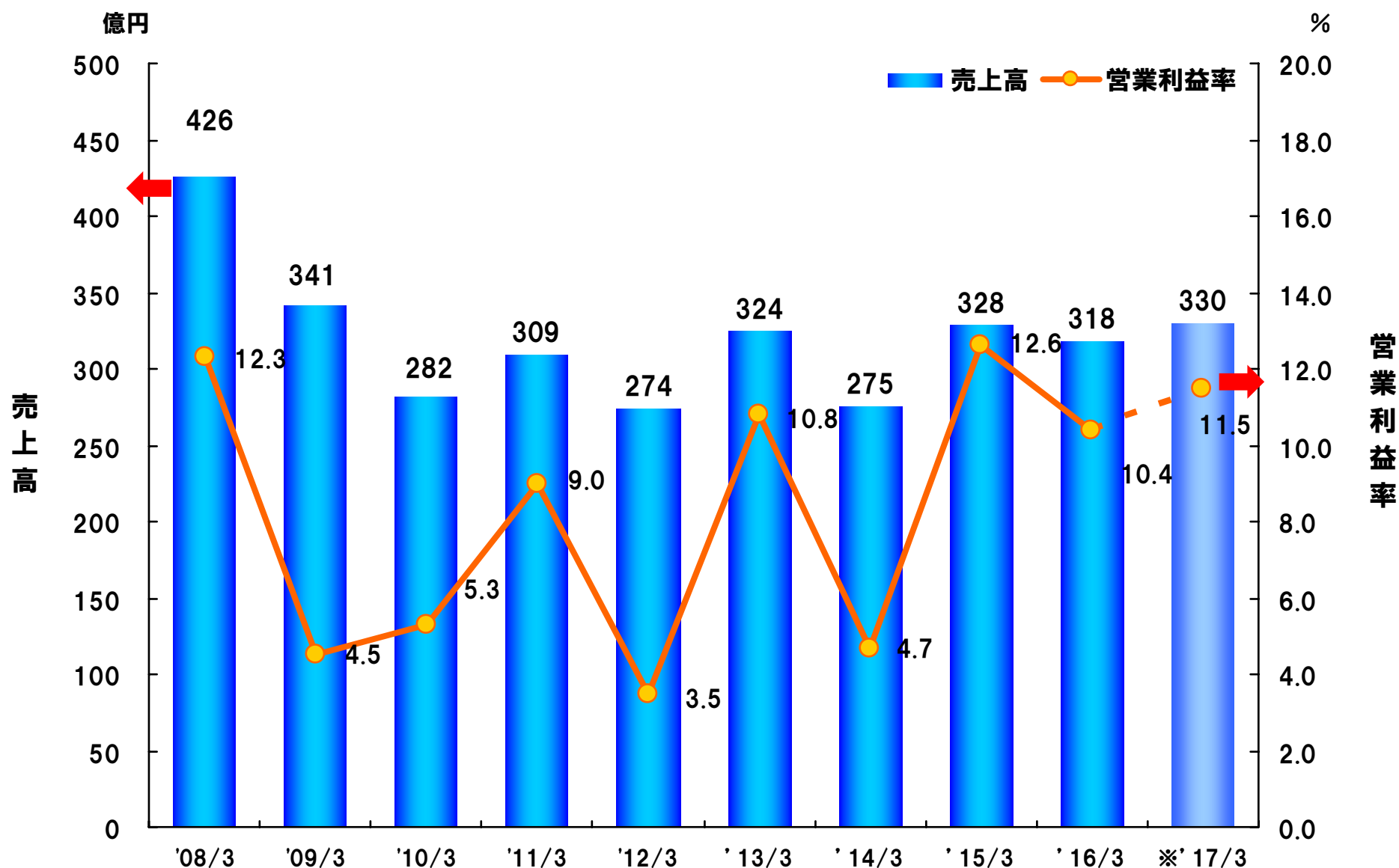
・半導体の在庫調整が終了し、一般工業用研磨材が回復、増収3.9%予想
CMP(+4.7%)、一般工業用研磨材(+13.8%)

業績予想（半期）

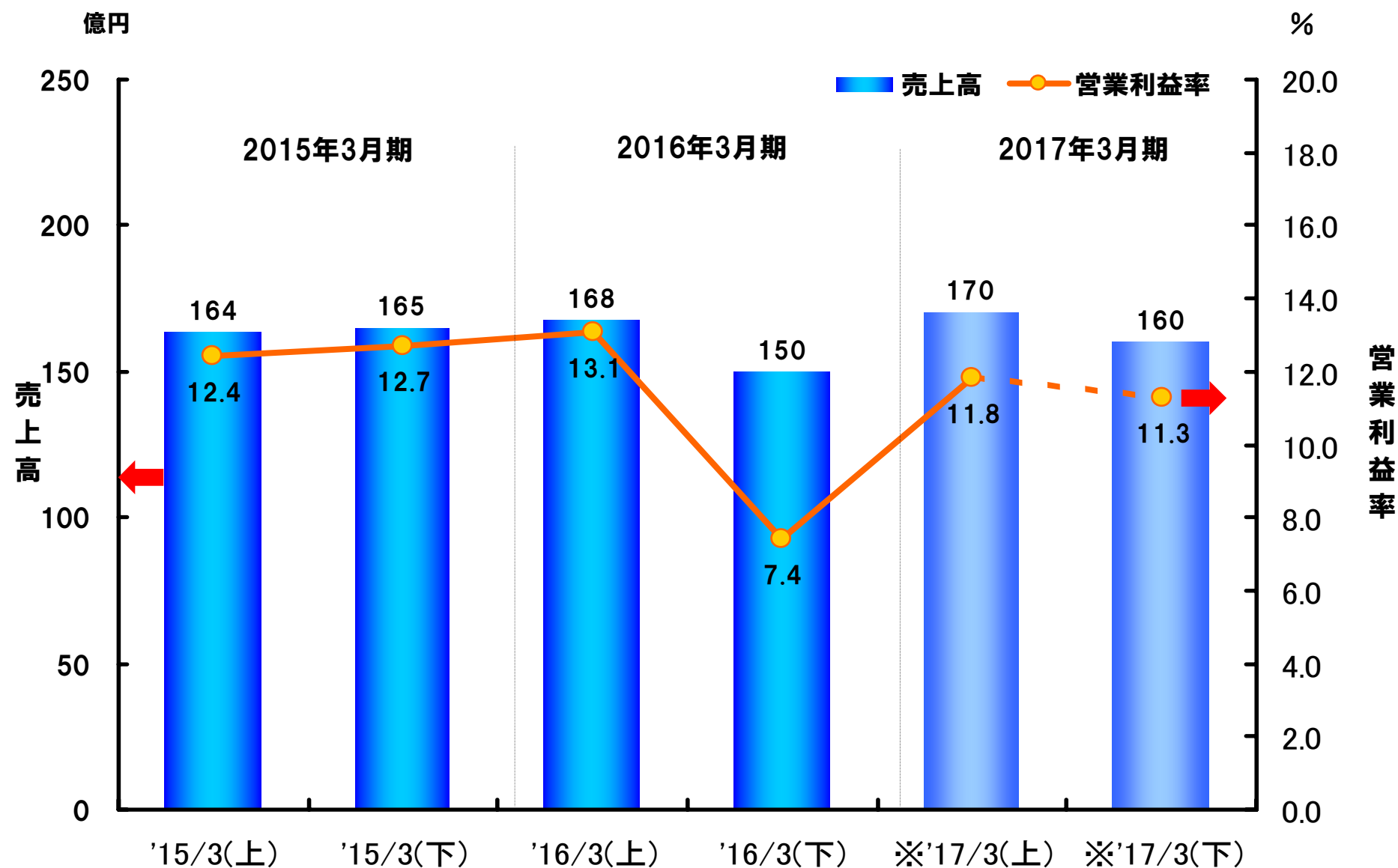
単位:百万円	16年3月期		17年3月期				
	上期実績	下期実績	上期予想	前年同期比	前年下期比	下期予想	前年同期比
売上高	16,753	15,002	17,000	+1.5%	+13.3%	16,000	+6.7%
営業利益	2,187	1,115	2,000	△8.6%	+79.4%	1,800	+61.4%
営業利益率	13.1%	7.4%	11.8%	-	-	11.3%	-
経常利益	2,441	901	2,050	△16.0%	+127.5%	1,850	+105.3%
経常利益率	14.6%	6.0%	12.1%	-	-	11.6%	-
当期純利益	1,739	607	1,500	△13.8%	+147.1%	1,300	+114.2%

- ・上期170億円、下期160億円の予想
- ・半導体関連（シリコン・CMP）、一般工業用研磨材における最終製品の需要サイクルによるもの

業績推移（通期）



業績推移（半期）



用途別売上高

用途別売上高（通期実績）

単位:百万円		15年3月期	16年3月期	
		通期実績	通期実績	前年比
シリコン	ラッピング	3,277	3,171	△3.2%
	ポリシング	5,871	5,753	△2.0%
	切断	403	572	+41.9%
	計	9,552	9,498	△0.6%
CMP		10,143	10,980	+8.3%
ディスク	アルミディスク	2,916	3,523	+20.8%
	ガラスディスク	562	518	△7.8%
	計	3,478	4,041	+16.2%
機能材・溶射材	一般工業用（研磨材）	7,788	5,403	△30.6%
	一般工業用（非研磨材）	1,564	1,588	+1.5%
	計	9,353	6,991	△25.3%
製品売上高		32,527	31,510	△3.1%
商品売上高		287	244	△15.0%
売上高 合計		32,815	31,755	△3.2%

用途別売上高（半期実績）

単位:百万円		15年3月期		16年3月期					
		上期実績	下期実績	上期実績	前年同期比	前年下期比	下期実績	前年同期比	同年上期比
シリコン	ラッピング	1,667	1,609	1,614	△3.2%	+0.3%	1,557	△3.2%	△3.5%
	ポリシング	3,024	2,847	2,933	△3.0%	+3.0%	2,820	△0.9%	△3.9%
	切断	223	180	288	+29.1%	+60.0%	284	+57.9%	△1.4%
	計	4,915	4,637	4,836	△1.6%	+4.3%	4,661	+0.5%	△3.6%
CMP		4,888	5,254	5,771	+18.1%	+9.8%	5,209	△0.9%	△9.7%
ディスク	アルミディスク	1,302	1,613	1,667	+28.0%	+3.3%	1,856	+15.1%	+11.3%
	ガラスディスク	275	286	257	△6.5%	△10.1%	260	△9.1%	+1.2%
	計	1,577	1,900	1,924	+22.0%	+1.3%	2,116	+11.4%	+10.0%
機能材料・溶射材	一般工業用（研磨材）	4,083	3,705	3,335	△18.3%	△10.0%	2,067	△44.2%	△38.0%
	一般工業用（非研磨材）	722	842	743	+2.9%	△11.8%	844	+0.2%	+13.6%
	計	4,805	4,547	4,079	△15.1%	△10.3%	2,911	△36.0%	△28.6%
製品売上高		16,187	16,340	16,612	+2.6%	+1.7%	14,898	△8.8%	△10.3%
商品売上高		176	110	141	△19.9%	+28.2%	103	△6.4%	△27.0%
売上高 合計		16,363	16,451	16,753	+2.4%	+1.8%	15,002	△8.8%	△10.5%

用途別売上高（通期予想）

単位:百万円		15年3月期	16年3月期	17年3月期	
		通期実績	通期実績	通期予想	前年比
シリコン	ラッピング	3,277	3,171	3,110	△1.9%
	ポリシング	5,871	5,753	5,970	+3.8%
	切断	403	572	700	+22.4%
	計	9,552	9,498	9,780	+3.0%
CMP		10,143	10,980	11,500	+4.7%
ディスク	アルミディスク	2,916	3,523	3,410	△3.2%
	ガラスディスク	562	518	320	△38.2%
	計	3,478	4,041	3,730	△7.7%
機能材料・溶射材	一般工業用（研磨材）	7,788	5,403	6,150	+13.8%
	一般工業用（非研磨材）	1,564	1,588	1,620	+2.0%
	計	9,353	6,991	7,770	+11.1%
製品売上高		32,527	31,510	32,780	+4.0%
商品売上高		287	244	220	△9.8%
売上高 合計		32,815	31,755	33,000	+3.9%

用途別売上高（半期予想）

単位:百万円		16年3月期		17年3月期					
		上期実績	下期実績	上期予想	前年同期比	前年下期比	下期予想	前年同期比	同年上期比
シリコン	ラッピング	1,614	1,557	1,560	△3.3%	+0.2%	1,550	△0.4%	△0.6%
	ポリシング	2,933	2,820	2,990	+1.9%	+6.0%	2,980	+5.7%	△0.3%
	切断	288	284	380	+31.9%	+33.8%	320	+12.7%	△15.8%
	計	4,836	4,661	4,930	+1.9%	+5.8%	4,850	+4.1%	△1.6%
CMP		5,771	5,209	6,000	+4.0%	+15.2%	5,500	+5.6%	△8.3%
ディスク	アルミディスク	1,667	1,856	1,600	△4.0%	△13.8%	1,810	△2.5%	+13.1%
	ガラスディスク	257	260	150	△41.6%	△42.3%	170	△34.6%	+13.3%
	計	1,924	2,116	1,750	△9.0%	△17.3%	1,980	△6.4%	+13.1%
機能材料・溶射材	一般工業用（研磨材）	3,335	2,067	3,470	+4.0%	+67.9%	2,680	+29.7%	△22.8%
	一般工業用（非研磨材）	743	844	740	△0.4%	△12.3%	880	+4.3%	+18.9%
	計	4,079	2,911	4,210	+3.2%	+44.6%	3,560	+22.3%	△15.4%
製品売上高		16,612	14,898	16,890	+1.7%	+13.4%	15,890	+6.7%	△5.9%
商品売上高		141	103	110	△22.0%	+6.8%	110	+6.8%	±0.0%
売上高 合計		16,753	15,002	17,000	+1.5%	+13.3%	16,000	+6.7%	△5.9%

シリコン売上高（通期実績・予想、半期実績・予想）

《通期》

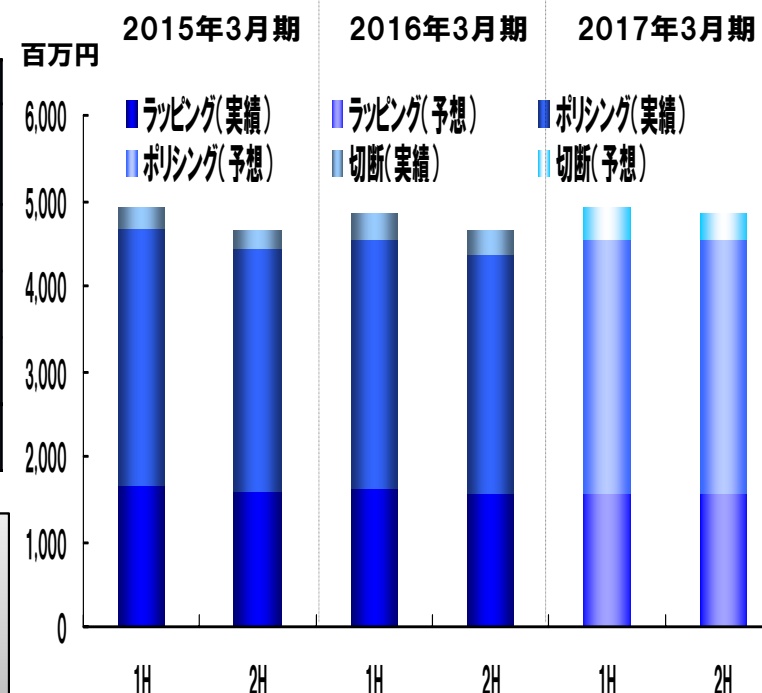
単位:百万円		15年3月期	16年3月期		17年3月期	
		通期実績	通期実績	前年比	通期予想	前年比
シリコン	ラッピング	3,277	3,171	△3.2%	3,110	△1.9%
	ポリシング	5,871	5,753	△2.0%	5,970	+3.8%
	切断	403	572	+41.9%	700	+22.4%
	計	9,552	9,498	△0.6%	9,780	+3.0%

《半期》

単位:百万円		15年3月期		16年3月期		17年3月期	
		上期実績	下期実績	上期実績	下期実績	上期予想	下期予想
シリコン	ラッピング	1,667	1,609	1,614	1,557	1,560	1,550
	ポリシング	3,024	2,847	2,933	2,820	2,990	2,980
	切断	223	180	288	284	380	320
	計	4,915	4,637	4,836	4,661	4,930	4,850

ポリシング ・16/3期:半導体在庫調整と一部失注による減収
 ・17/3期: 当社シェア拡大による増収
 （失注顧客の奪回、他顧客での採用拡大）

切断 ・当社シェア拡大による増収（最先端用途への適用）



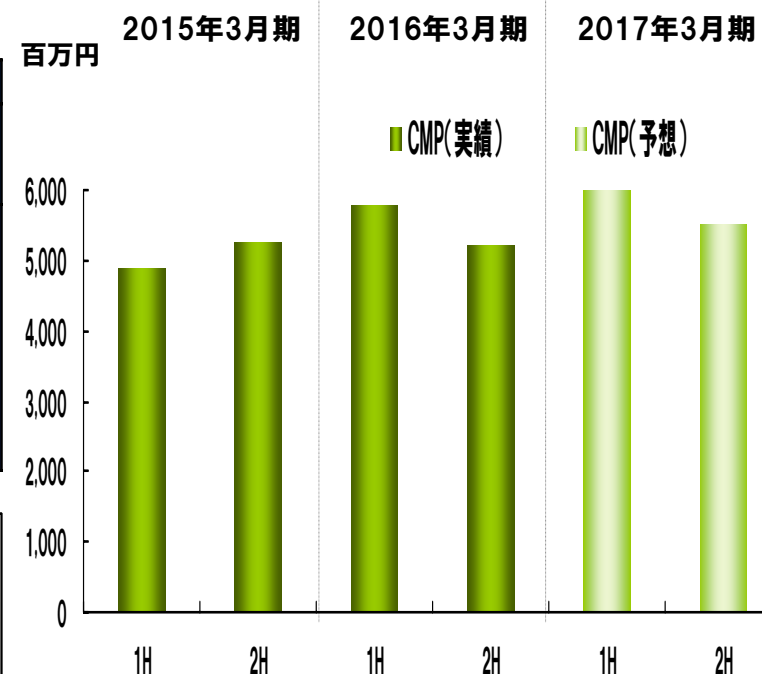
CMP売上高（通期実績・予想、半期実績・予想）

《通期》

単位:百万円	15年3月期	16年3月期		17年3月期	
	通期実績	通期実績	前年比	通期予想	前年比
CMP	10,143	10,980	+8.2%	11,500	+4.7%

《半期》

単位:百万円	15年3月期		16年3月期		17年3月期	
	上期実績	下期実績	上期実績	下期実績	上期予想	下期予想
CMP	4,888	5,254	5,771	5,209	6,000	5,500



- ・16/3期:アジアでの最先端ロジック(20・16nm)の増産および、最先端メモリデバイスでの採用
- ・17/3期:アジア16nm生産拡大、10nm量産開始、北米ロジック10nm量産開始、アジア最先端メモリデバイスでの採用拡大

ディスク売上高（通期実績・予想、半期実績・予想）

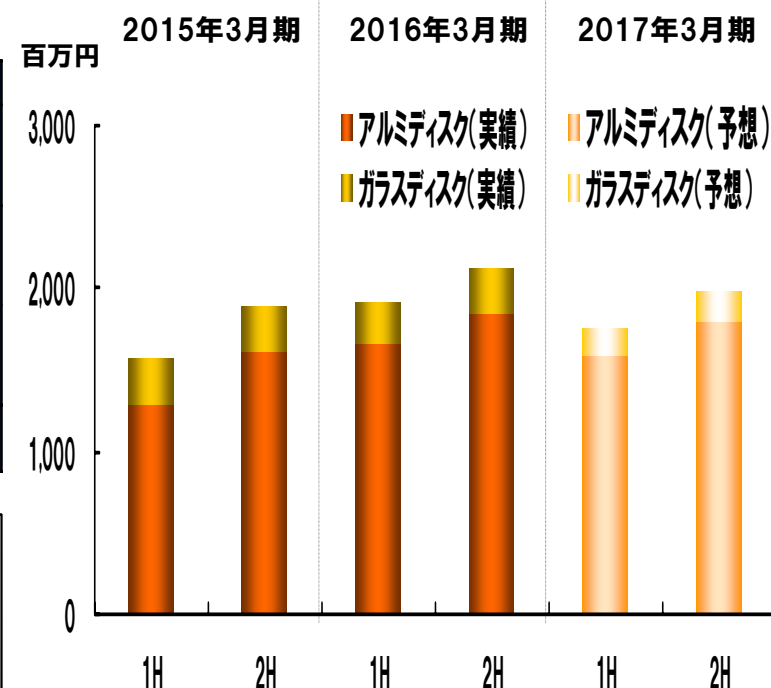
《通期》

単位:百万円		15年3月期	16年3月期		17年3月期	
		通期実績	通期実績	前年比	通期予想	前年比
ディスク	アルミディスク	2,916	3,523	+20.8%	3,410	△3.2%
	ガラスディスク	562	518	△7.9%	320	△38.2%
	計	3,478	4,041	+16.2%	3,730	△7.7%

《半期》

単位:百万円		15年3月期		16年3月期		17年3月期	
		上期実績	下期実績	上期実績	下期実績	上期予想	下期予想
ディスク	アルミディスク	1,302	1,613	1,667	1,856	1,600	1,810
	ガラスディスク	275	286	257	260	150	170
	計	1,577	1,900	1,924	2,116	1,750	1,980

- ・16/3期: HDD市場は縮小傾向にあるも、アルミディスク向け製品のシェア拡大により増収
- ・17/3期: 引き続きシェアアップを目指すも、足下の在庫調整の影響が残ることから減収



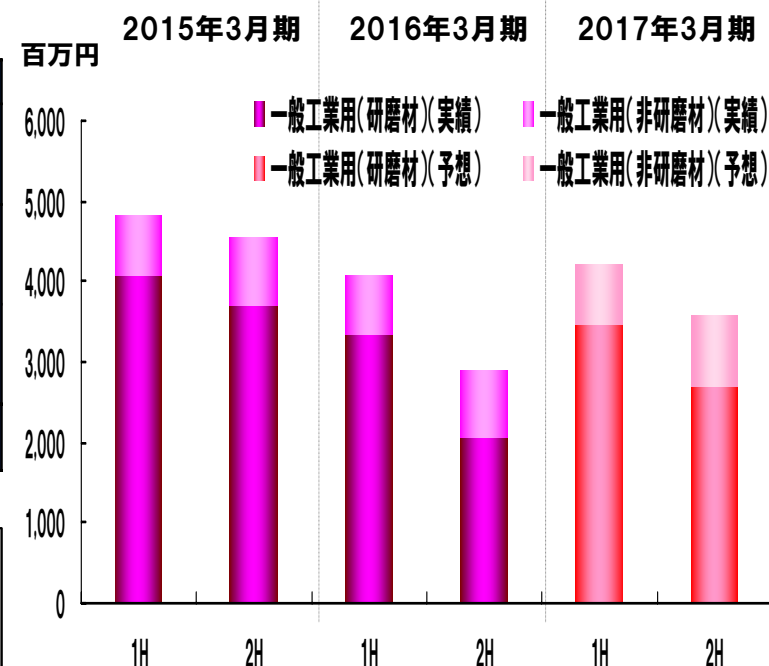
機能材・溶射材売上高（通期実績・予想、半期実績・予想）

《通期》

単位:百万円		15年3月期	16年3月期		17年3月期	
		通期実績	通期実績	前年比	通期予想	前年比
機能材・溶射材	一般工業用(研磨材)	7,788	5,403	△30.6%	6,150	+13.8%
	一般工業用(非研磨材)	1,564	1,588	+1.5%	1,620	+2.0%
	計	9,353	6,991	△25.3%	7,770	+11.1%

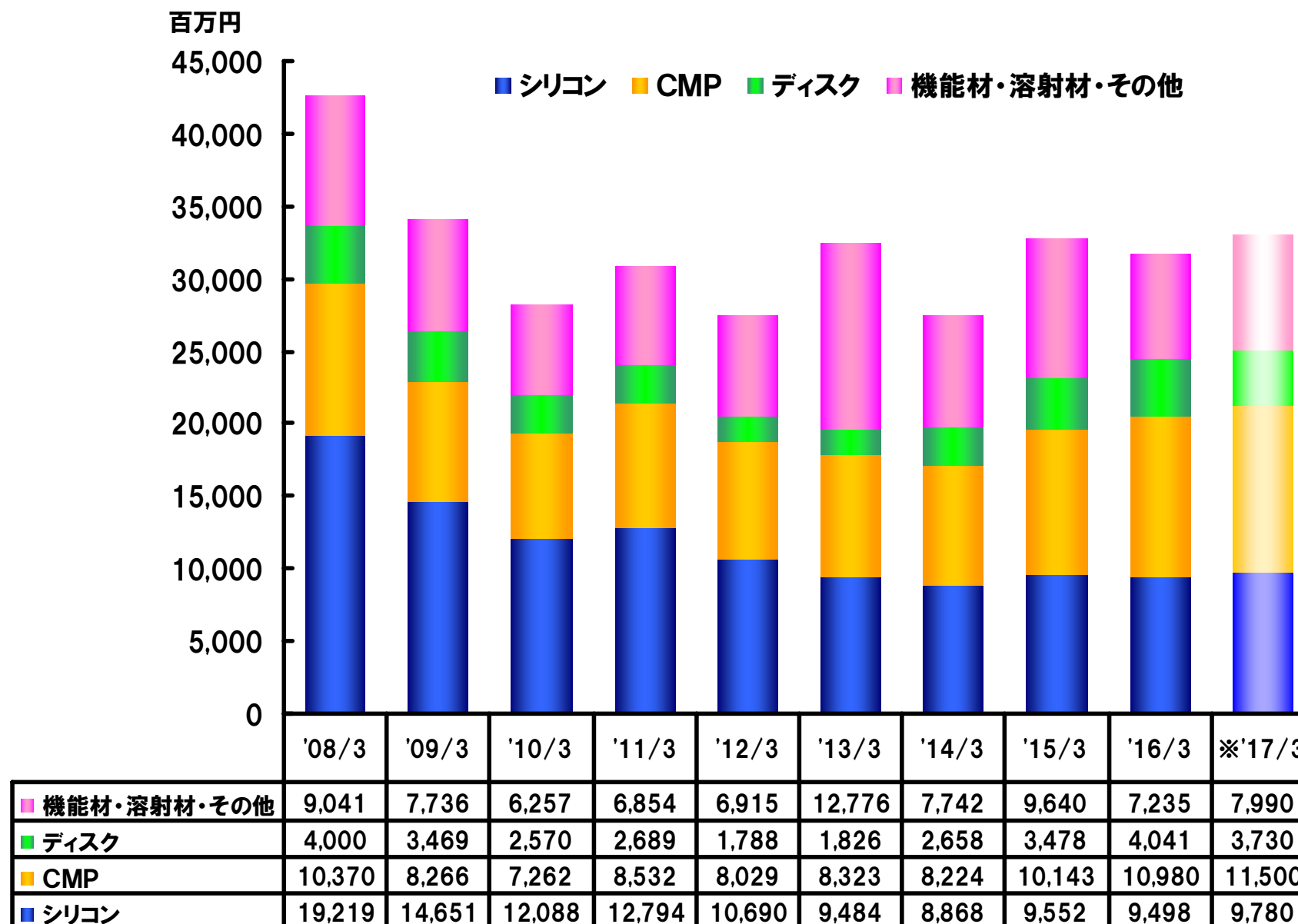
《半期》

単位:百万円		15年3月期		16年3月期		17年3月期	
		上期実績	下期実績	上期実績	下期実績	上期予想	下期予想
機能材・溶射材	一般工業用(研磨材)	4,083	3,705	3,335	2,067	3,470	2,680
	一般工業用(非研磨材)	722	842	743	844	740	880
	計	4,805	4,547	4,079	2,911	4,210	3,560

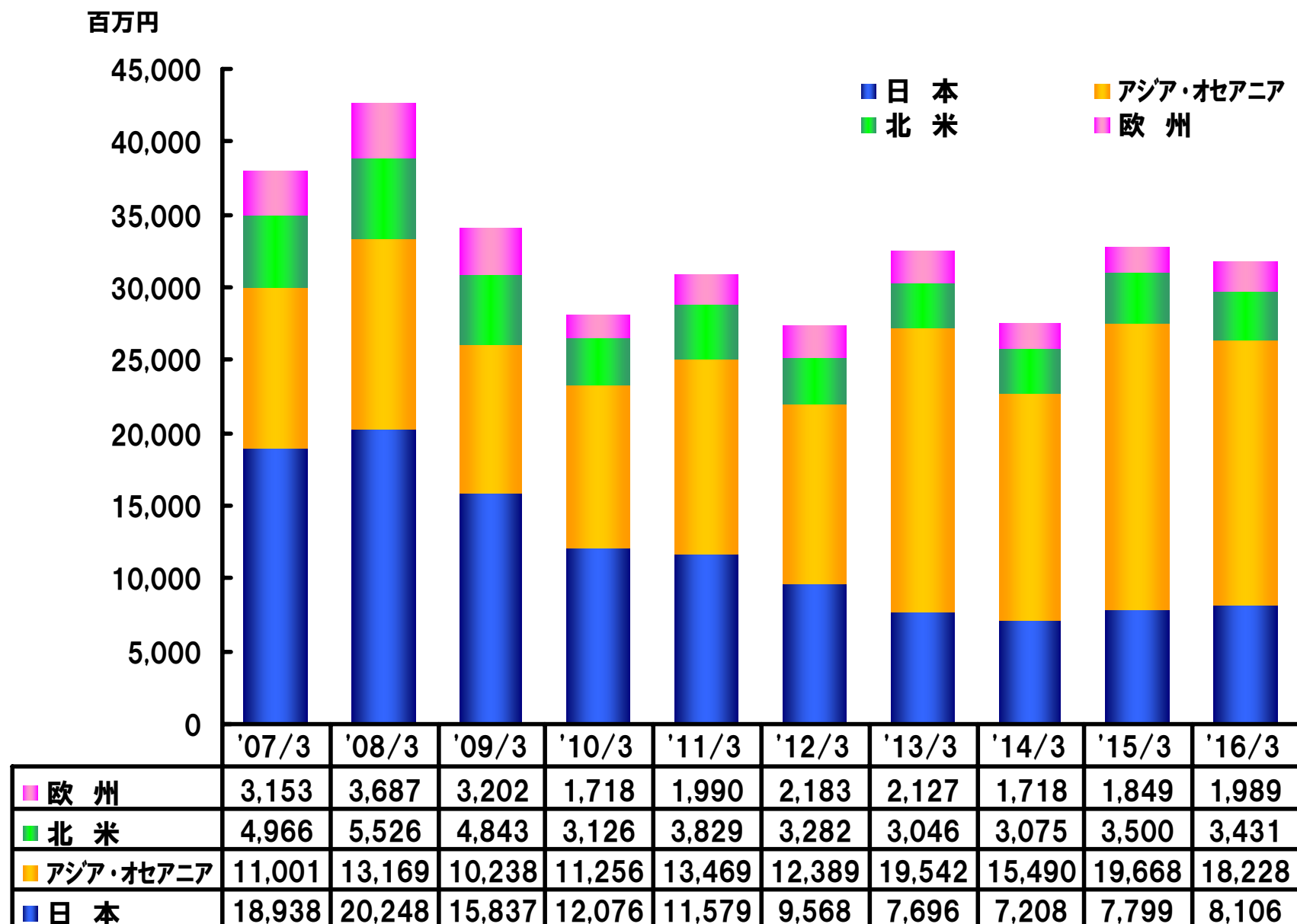


- ・16/3期: モバイル・ディスプレイ関連用途向けで、最終製品の需要減退、顧客でのプロセス最適化と当社シェア低下により減収
- ・17/3期: 同用途で、最終製品次世代品での採用により増収

用途別売上高（通期）



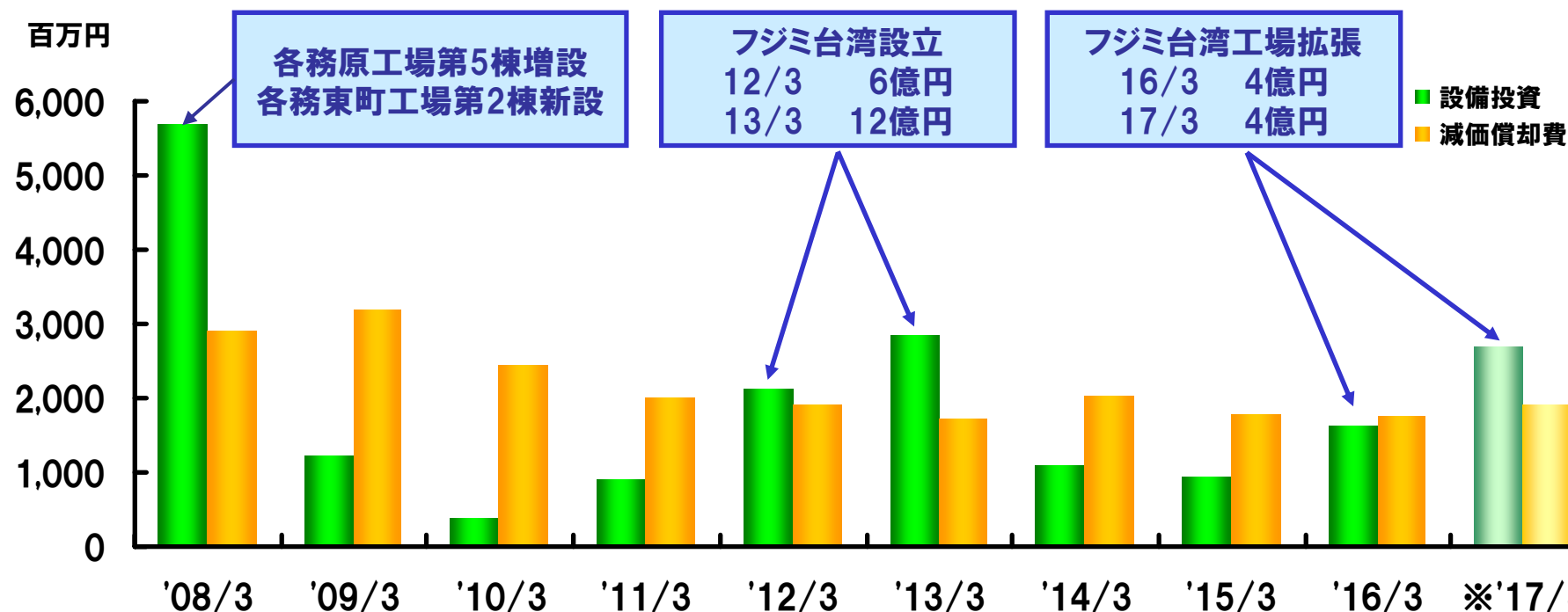
地域別売上高（通期）



設備投資額 減価償却費 研究開発費

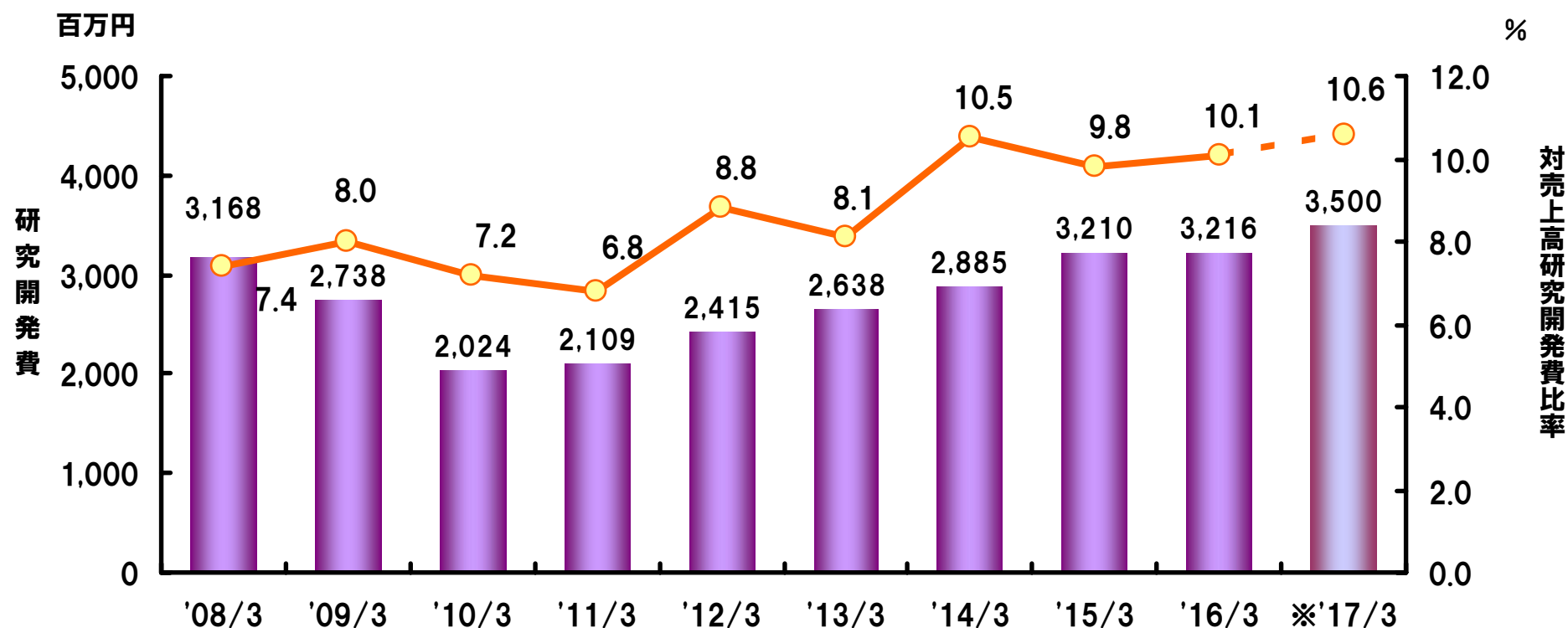
設備投資額・減価償却費

単位: 百万円	15年3月期	16年3月期				17年3月期	
	通期実績	通期計画	通期実績	前年比	計画比	通期計画	前年実績比
設備投資額	947	2,611	1,637	+72.9%	△37.3%	2,300	+40.5%
減価償却費	1,794	1,923	1,754	△2.2%	△8.8%	1,900	+8.3%



研究開発費／売上高比

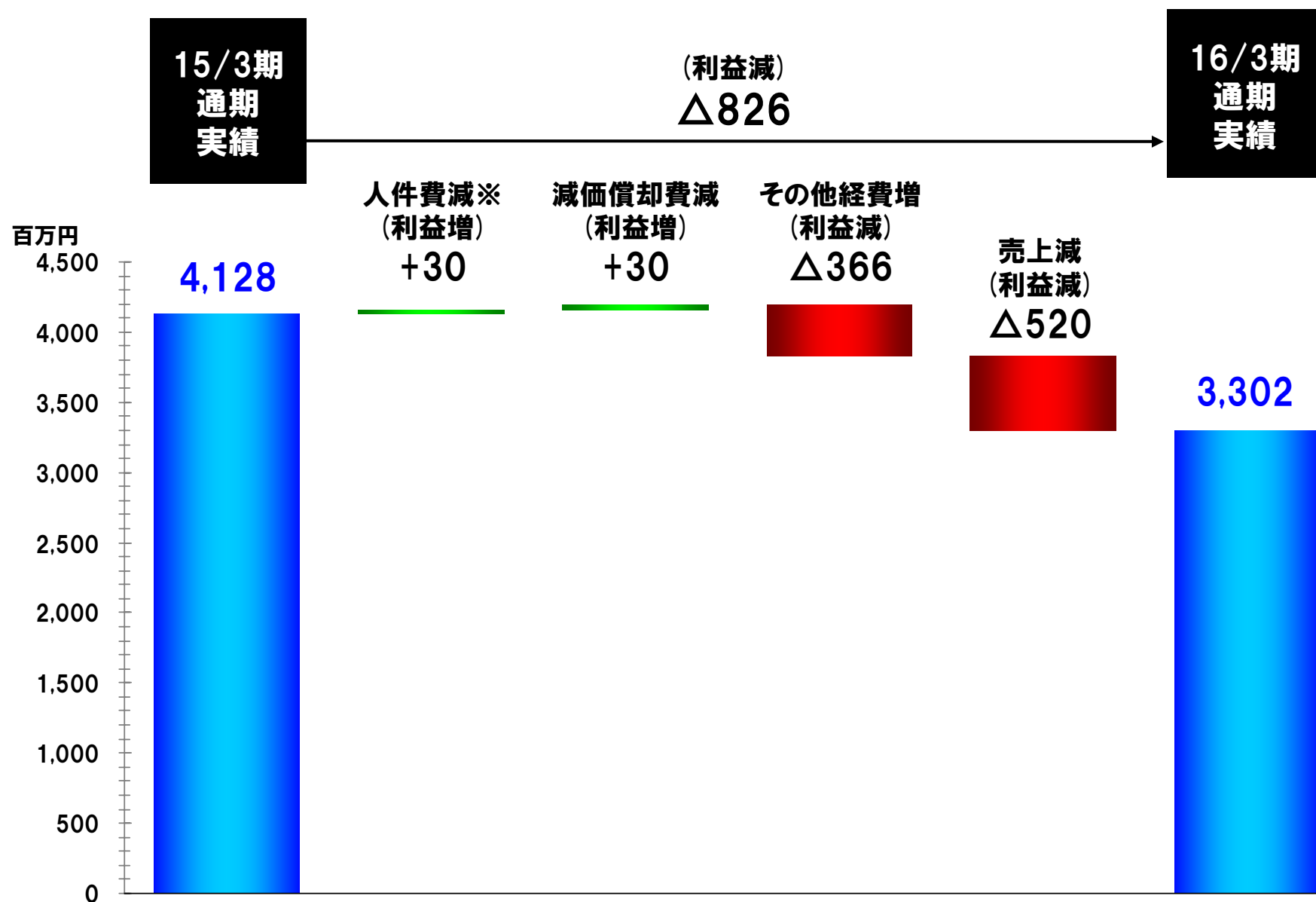
単位： 百万円	15年3月期	16年3月期				17年3月期	
	通期 実績	通期 計画	通期 実績	前年比	計画比	通期 計画	前年実績比
研究開発費	3,210	3,311	3,216	+0.2%	△2.9%	3,500	+8.8%



損益分析

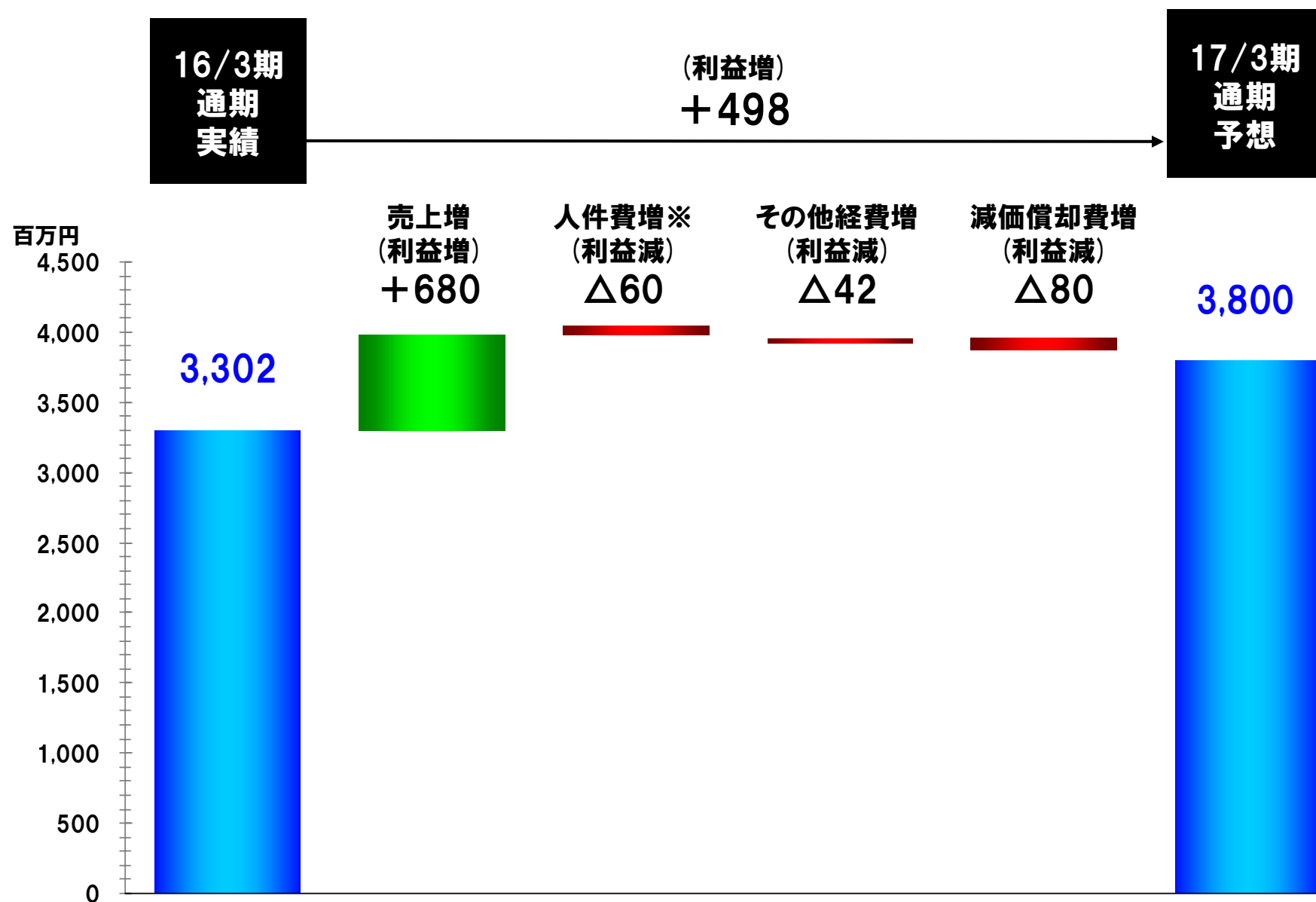
営業利益増減要因

15/3期通期実績→16/3期通期実績



営業利益増減要因

16/3期通期実績→17/3期通期予想

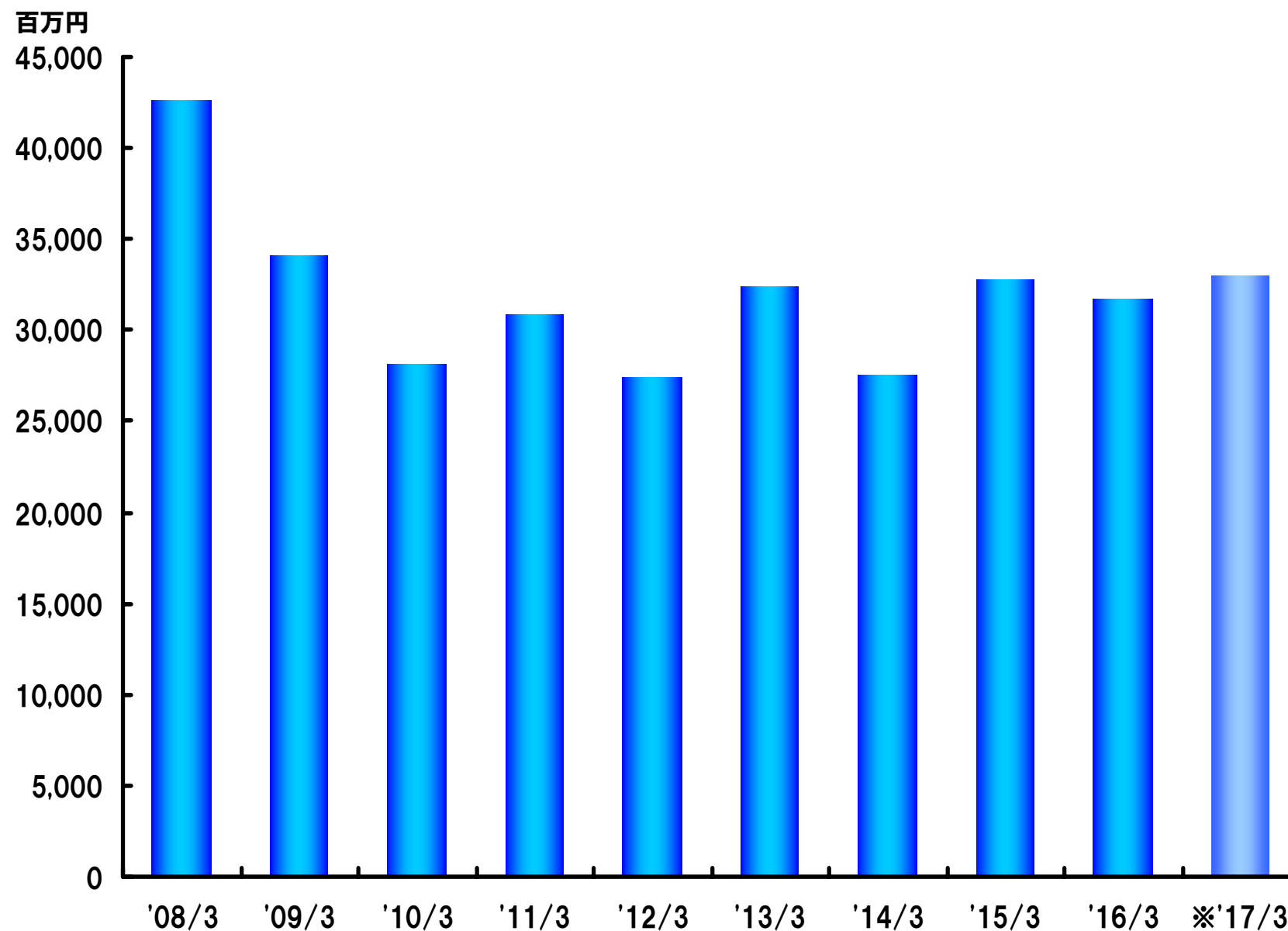


補足説明資料 マーケットデータ等

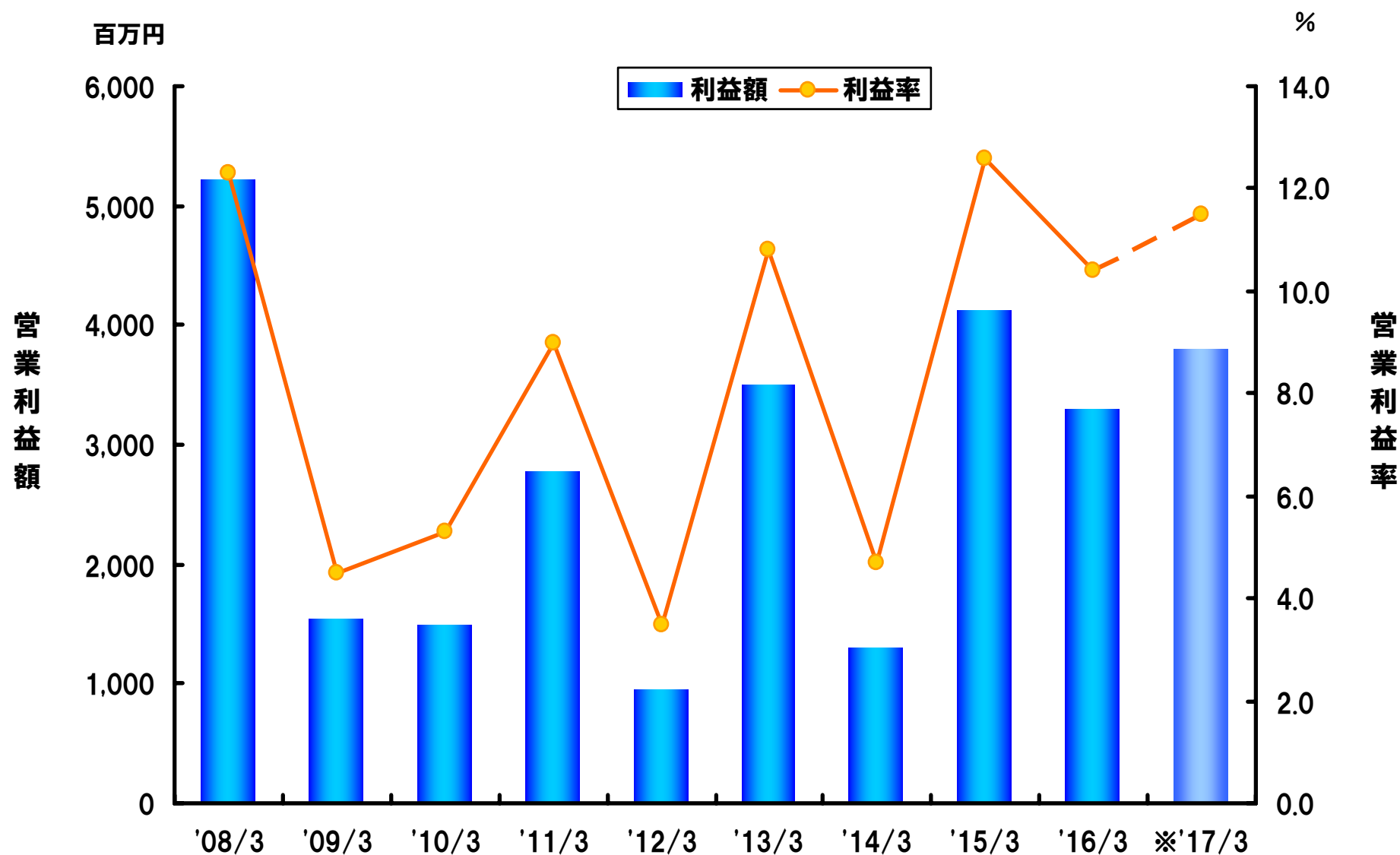
グループ人員 内訳

(人数)	15年3月期 (3月31日現在)		16年3月期 (3月31日現在)			
	正社員	臨時 雇用者※	正社員	臨時 雇用者※	前期末増減	
					正社員	臨時 雇用者
フジミインコーポレーテッド	554	131	559	148	+5	+17
フジミコーポレーション	107	1	104	0	△3	△1
フジミ台湾	71	1	72	2	+1	+1
フジミマイクロテクノロジー	58	4	64	8	+6	+4
フジミヨーロッパ	4	1	4	1	—	—
フジミ韓国	3	0	3	0	—	—
フジミ深圳	1	0	5	0	+4	—
合 計	798	138	811	159	+13	+21

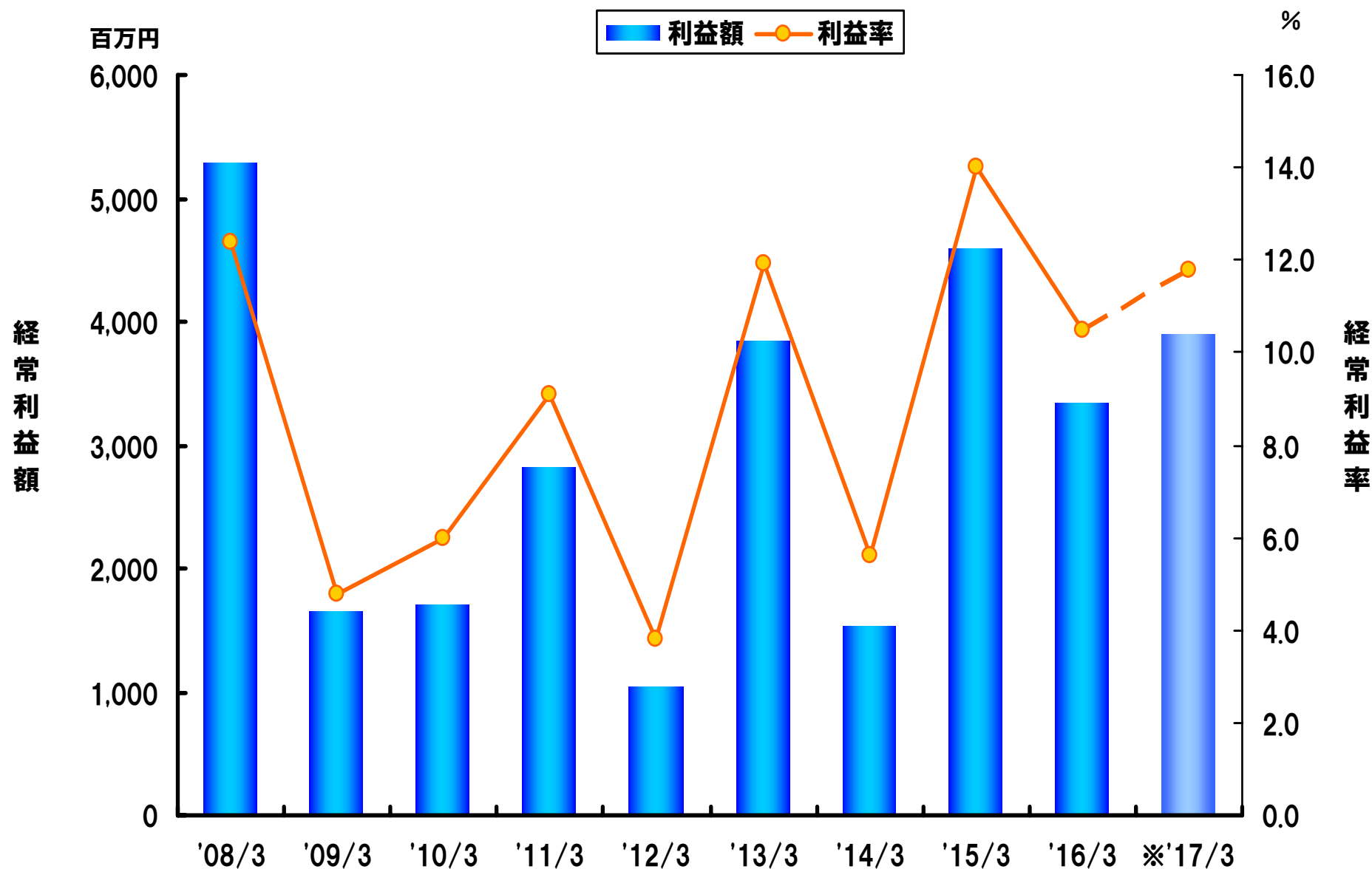
売上高（通期）



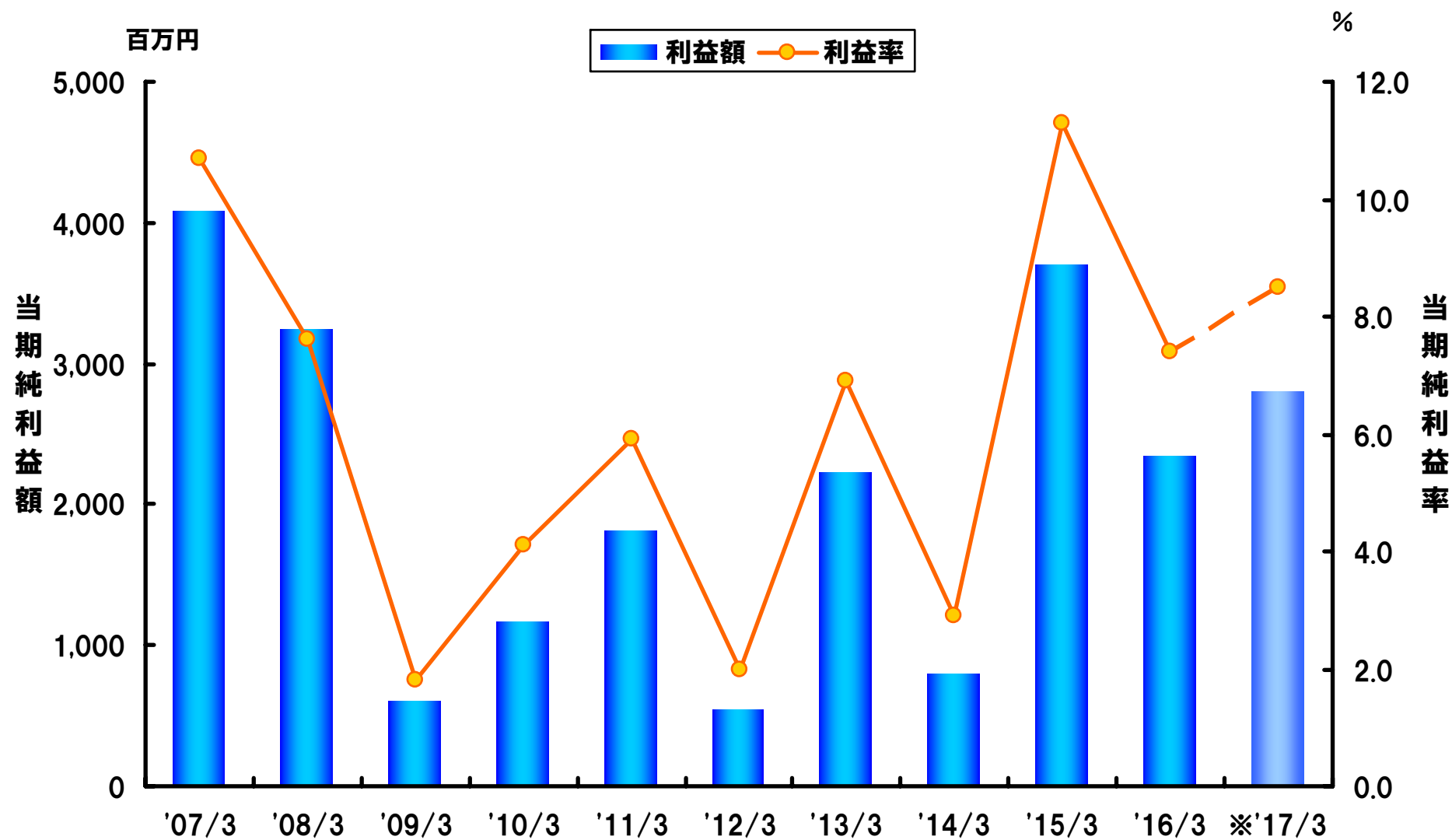
営業利益（通期）



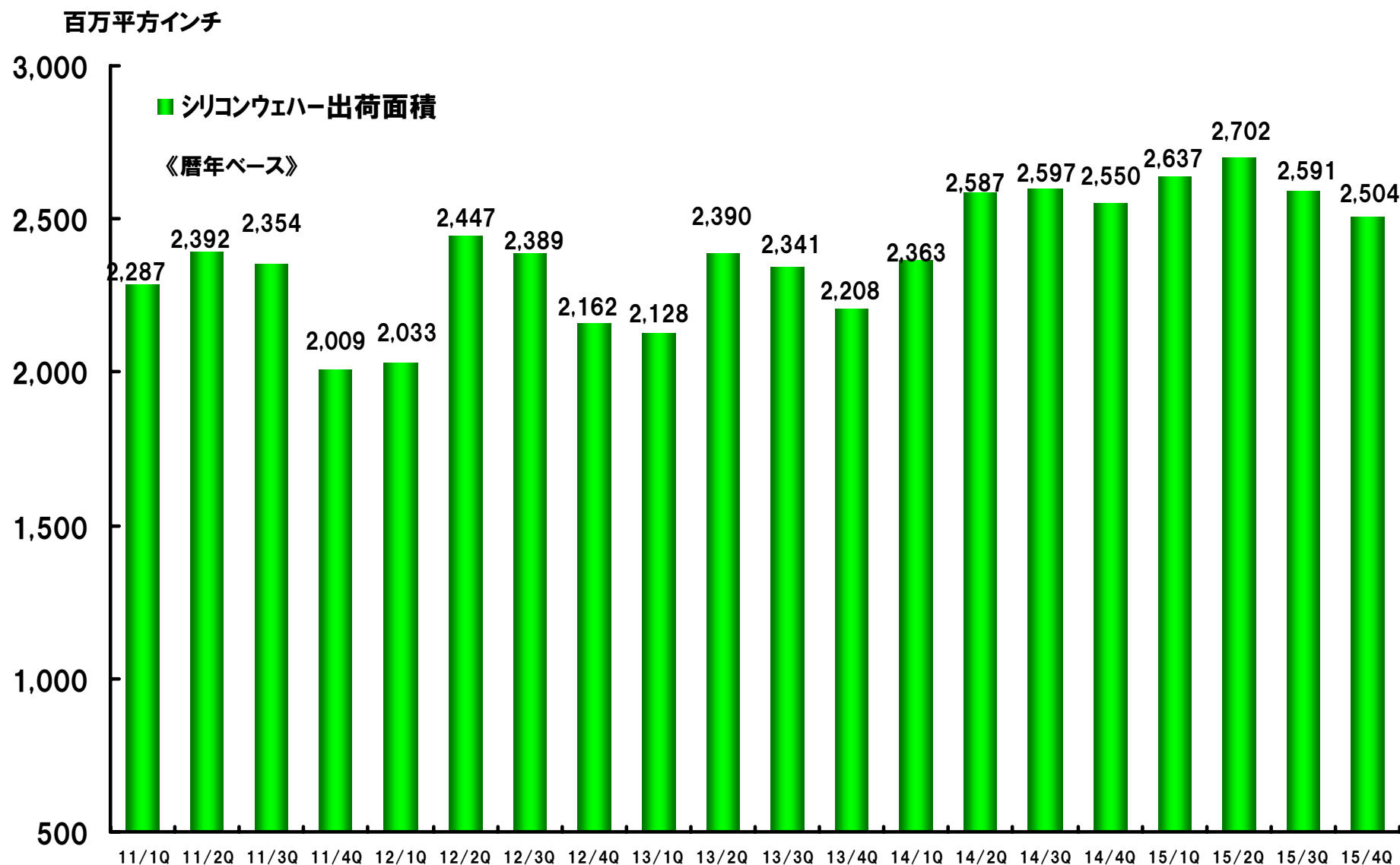
経常利益（通期）



当期純利益（通期）



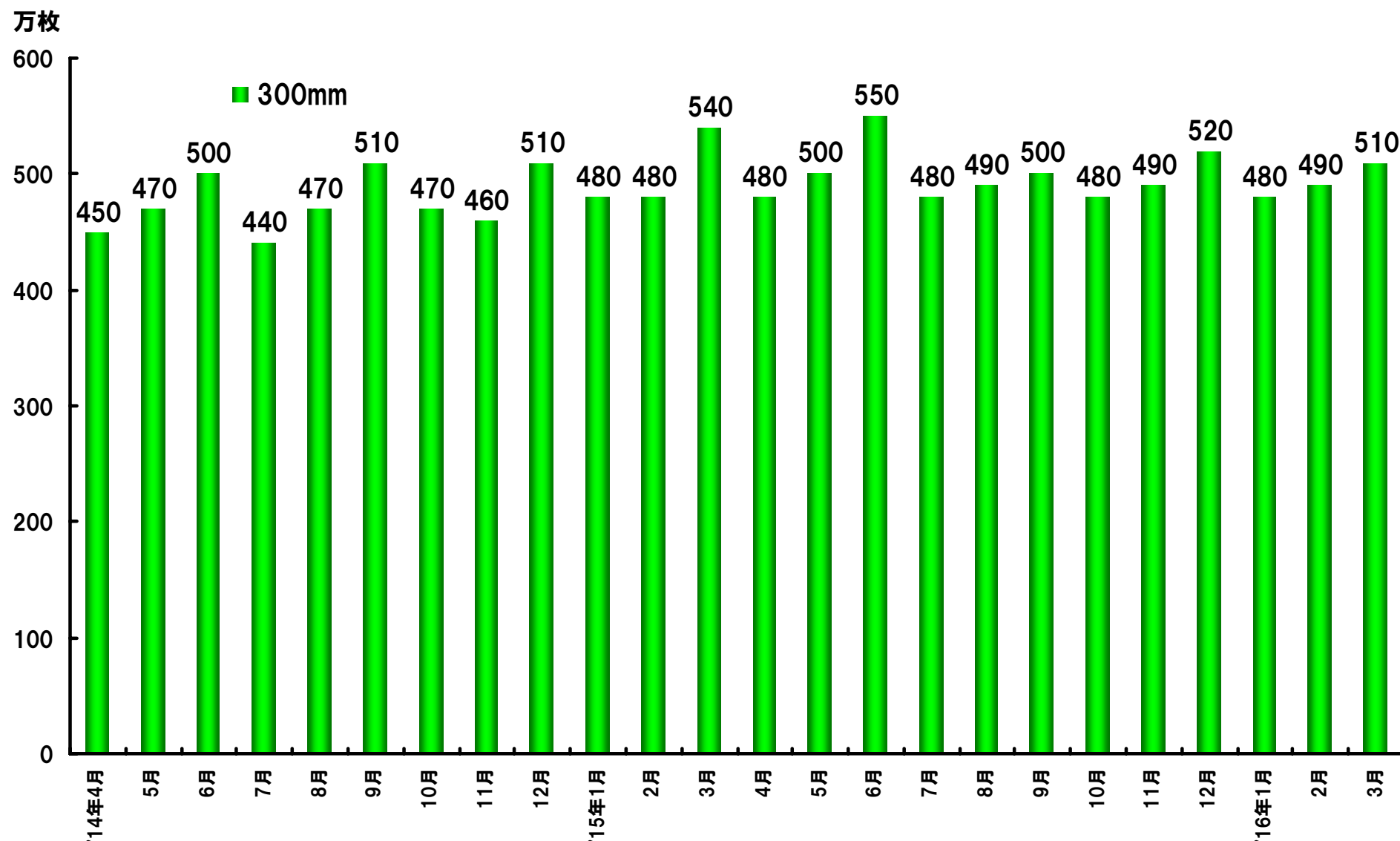
シリコンウェハー出荷面積（四半期）



出所: SEMI(Semiconductor Equipment and Materials International) 2016年2月

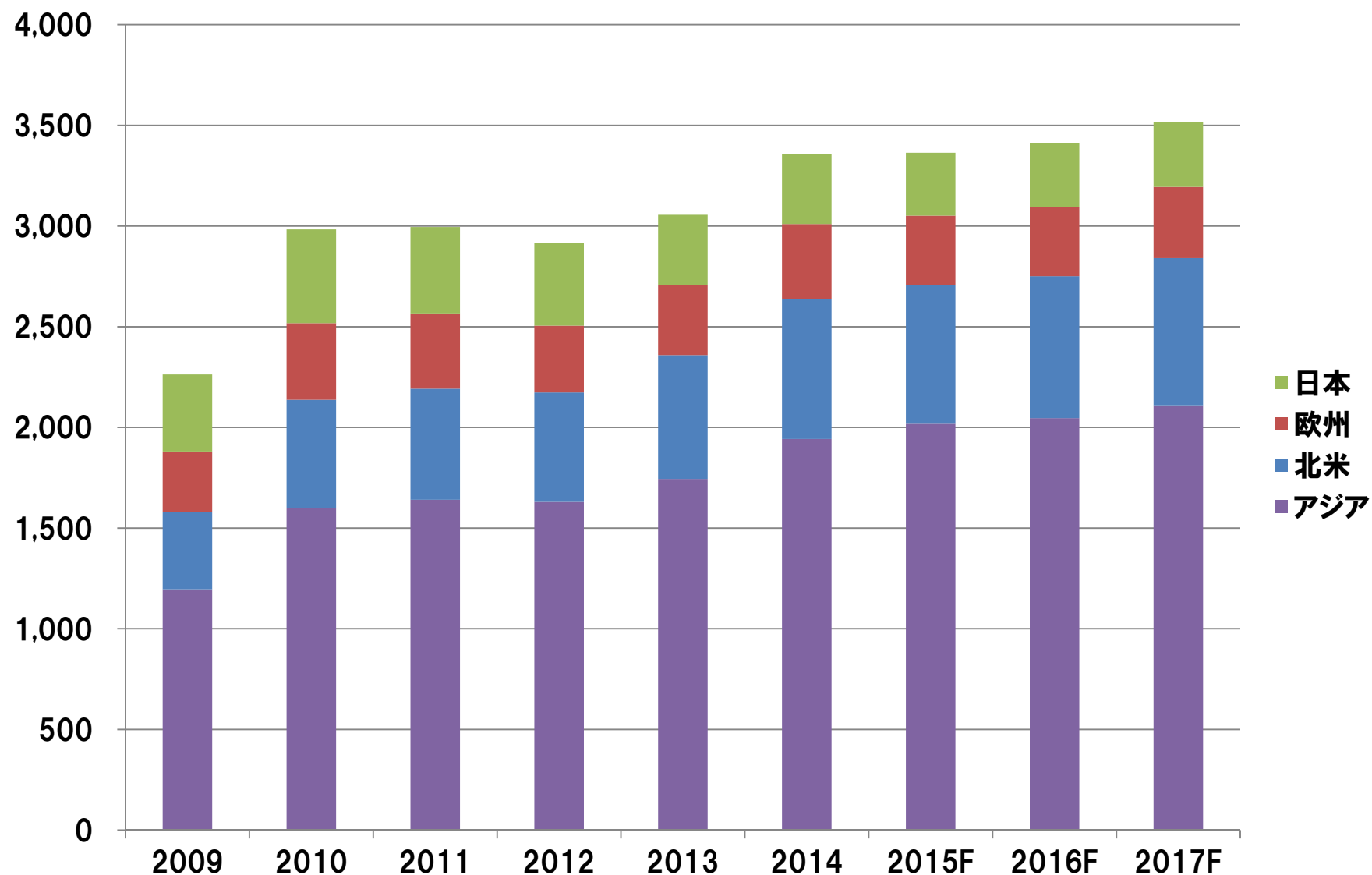
300mmシリコンウェハー出荷枚数(月次)

出所：自社推定



半導体市場規模（地域別）

（単位：億ドル）



以 上